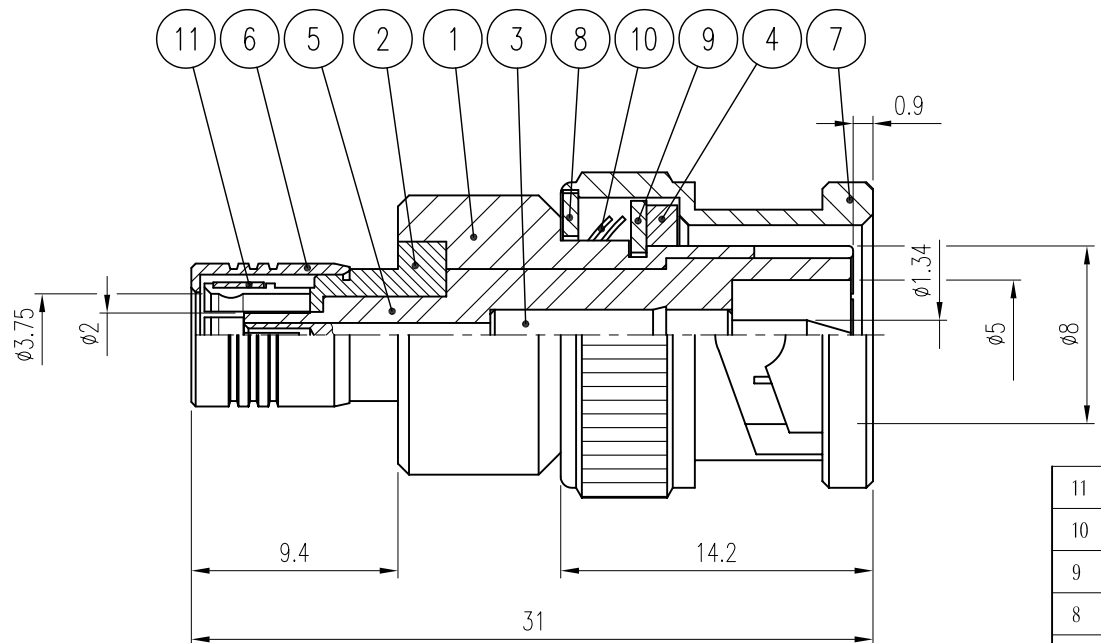


ST	가공										수 정 내 용			
											부호	내 용	수정자	승인자
ST(기준)										1	생산성향상(BODY분할)	김은희	안병호	2003. 12. 4.
ST(개선)														



11	SPRING RING	1	BeCu	Gold Plate	DSR00004-N45/1 (R3001) DSR00004-5/2 (R3001)
10	SPRING WASHER	2	BeCu	Nickel Plate	DWA00069-N45/1 (R6001)
9	WASHER	2	MBsBD	Nickel Plate	DWA00016-N5/1 (Q6002)
8	WASHER	1	MBsBD	Nickel Plate	DWA00015-N5/1 (Q6001)
7	COUPLING CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00044-135/1 (K6001)
6	COUPLING CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00023-135/1 (K3004)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DAI00029-N/1 (HA019)
4	GASKET	1	SILICON		DGK00012-N/1 (G6001)
3	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DAC00040-1345/1 (EA017)
2	BODY(B)	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00472-135/1 (DA021B)
1	BODY(A)	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00663-135/1 (DA021A)

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	2000. 1. 7.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인					
재질	검도			도명	BNCP-SMBP	
	제도					
열처리	작성부서		연 구 소		A4	도번 AD00039-7/1
보호피막처리	적도 3/1					
						K361-524-000

RF & MICROWAVE TECHNOLOGY

KJ COMTECH CO.,LTD.

BNCP-SMBP

A4

도번 AD00039-7/1

K361-524-000